

社発第 T-810 号
2025 年 3 月 3 日

貸借取引参加者
代 表 者 殿

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社
代表執行役社長 櫛田 誠希

貸借取引対象銘柄の追加について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、今般当社は標記の件を下記のとおり実施することといたしましたので、ご通知申し上げます。
敬 具

記

1. 貸借取引対象銘柄の追加

(1) 貸借銘柄

(東京証券取引所市場分)

NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置 35%キャップ指数連動型上場投信 受益証券 (346A)

実施日 2025 年 3 月 27 日 (木) (約定日) … 上場日と同日

(2) 貸借融資銘柄

(PTS 分)

NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置 35%キャップ指数連動型上場投信 受益証券 (346A)

実施日 2025 年 3 月 27 日 (木) (約定日)

なお、上記受益証券につきましては、上場日から起算して 3 営業日目の日 (3 月 31 日) から貸借担保金代用有価証券として受入れる (代用掛目は時価の 80%以内) ことといたします。

(注) PTS 分の貸借取引対象銘柄は、各 PTS により異なる場合がございますので、詳細は各 PTS 運営業者までご照会ください。

以 上